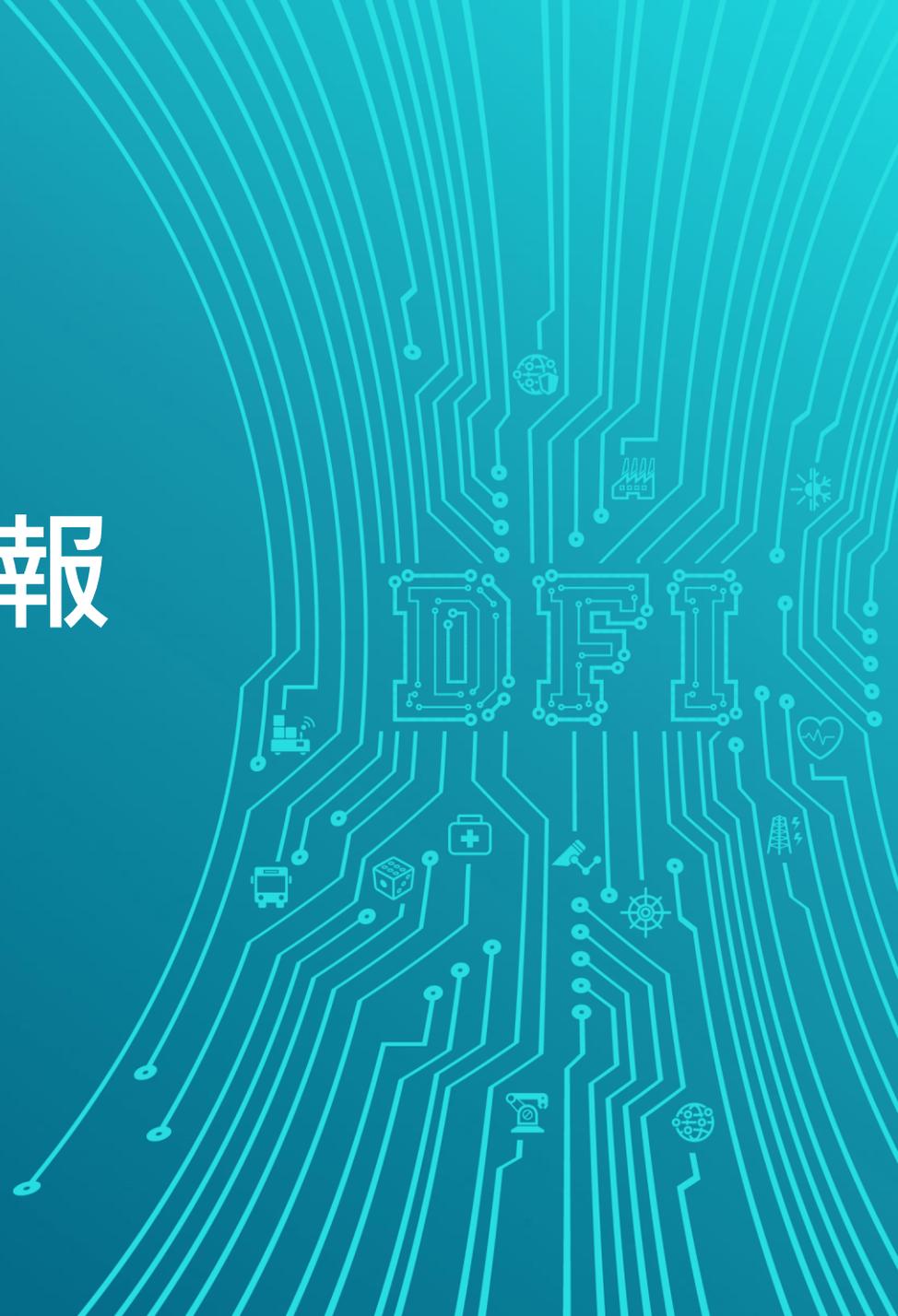
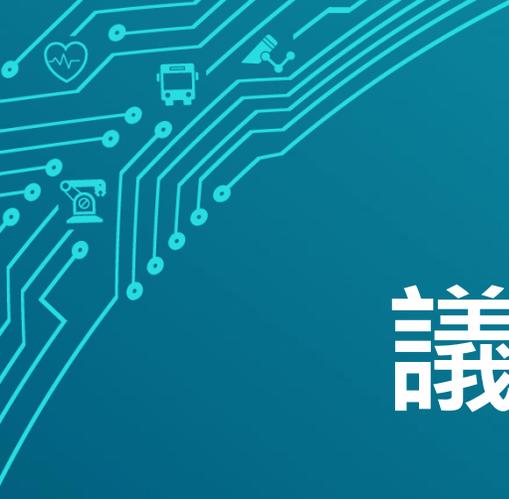


**DFI**

# 2024第一季營運簡報

2024年5月10日





# 議程

- 一. 2024第一季財務結果及業務摘要
- 二. 營運展望
- 三. Q & A

# 免責聲明

本次法說會提供之簡報包含前瞻性陳述，內容包含本公司財務狀況、未來擴張計劃及公司策略等訊息。此前瞻性陳述係基於本公司目前可得資訊對未來事件的期望和預測，儘管本公司認為該期望和預測具合理性，但此類前瞻性聲明仍涉及風險及不確定性。

鑒於這些風險、不確定性及假設，前瞻性事件可能不會發生，且本公司實際結果可能與這些前瞻性聲明中的預期存在重大差異。若因未來實際結果與預期狀況有重大差異，須公開更新或修改任何前瞻性陳述，本公司將不承擔此責任。



# 一. 2024第一季財務結果及業務摘要

# 合併綜合損益表摘要

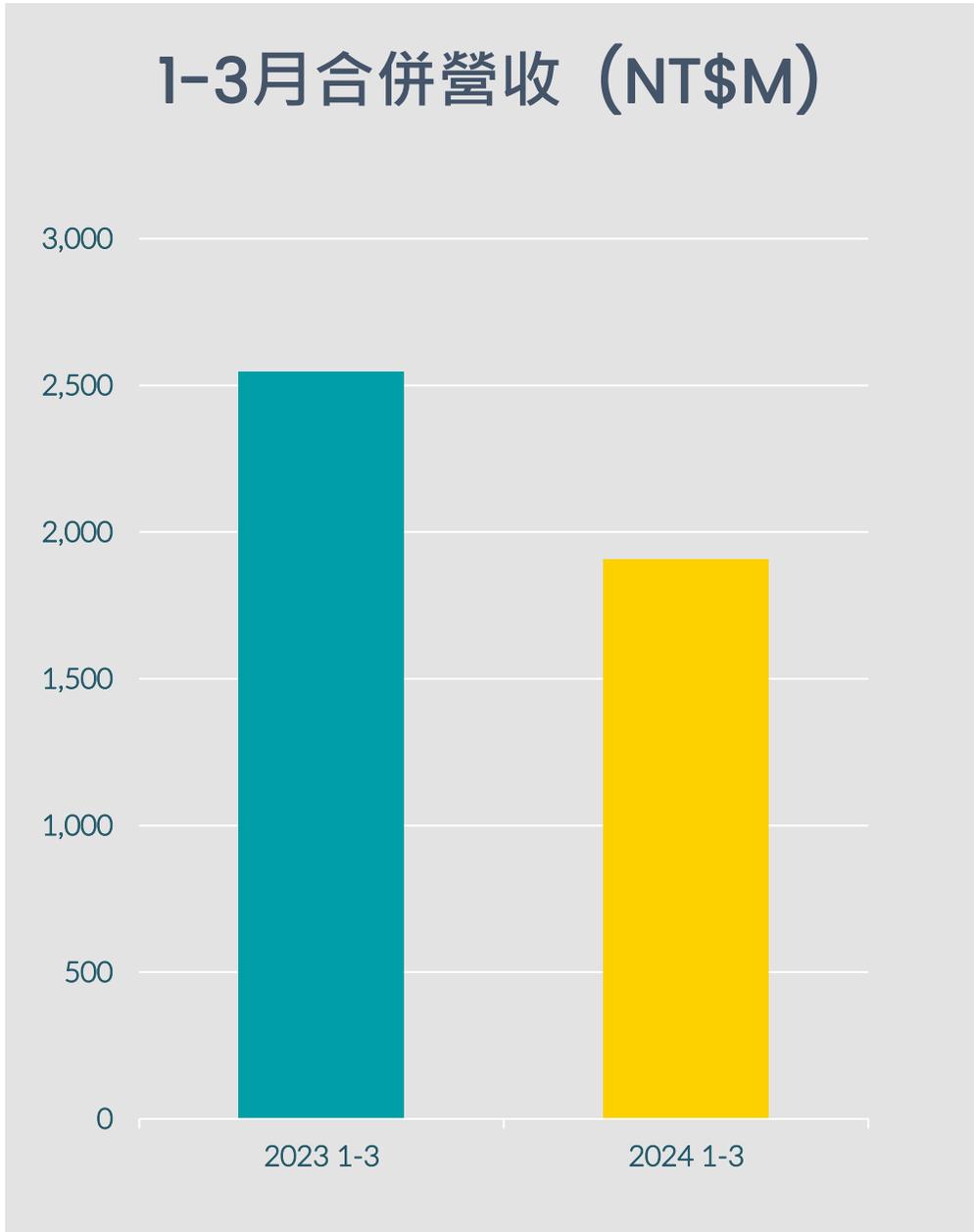
單位：新台幣千元

	YTD 2024年1-3月		YTD 2023年1-3月	
銷貨淨額	1,906,186	100.0%	2,548,145	100.0%
營業成本	(1,380,731)		(1,865,804)	
營業毛利	525,455	27.6%	682,341	26.8%
營業費用	(451,199)	-23.7%	(478,243)	-18.8%
營業淨利	74,256	3.9%	204,098	8.0%
營業外收支及費用	680		(22,008)	
稅前淨利	74,936	3.9%	182,090	7.1%
本期淨利	54,831	2.9%	126,151	5.0%
本期淨利歸屬於母公司業主	51,950	2.7%	125,461	4.9%
基本每股盈餘(NT\$(a))	\$0.45		\$1.10	

(a)基本每股盈餘以加權平均流通在外股數計算(千股)

114,488

114,488



# 合併資產負債表摘要

單位：新台幣千元

	2024.03.31		2023.12.31		2023.03.31	
現金及約當現金	1,544,646	17%	1,490,285	16%	1,496,874	12%
應收票據及帳款(含關係人)	1,878,919	22%	1,939,296	22%	2,691,239	22%
存貨	1,755,982	20%	1,893,457	21%	3,540,793	29%
不動產、廠房及設備	2,351,456	26%	2,548,819	28%	2,647,493	21%
總資產	8,940,746	100%	9,101,605	100%	12,409,579	100%
流動負債	3,075,562	34%	2,909,498	32%	4,930,757	40%
非流動負債	1,171,443	13%	1,209,225	13%	2,015,811	16%
權益總計	4,693,741	53%	4,982,882	55%	5,463,011	44%
每股淨值 (NT\$)	25.24		27.62		25.65	
每股淨值以流通在外股數計算(千股)	114,488		114,488		114,488	

# 重要財務指標

	2024.03.31	2023.12.31	2023.03.31
應收帳款週轉天數	91	98	67
存貨週轉天數	120	174	112
應付帳款週轉天數	62	83	63
營運資金週轉天數	149	189	116
權益報酬率(年化)(a)	4.5%	6.5%	8.9%
流動比率	173%	188%	161%
金融負債比率 (b)	20%	21%	22%

(a)採年化稅後損益/平均權益總額

(b)金融負債包含長短期借款



## 二. 營運展望

# 友通產品佈局

## Computer on Module

全球最小  
SBC設計



軍規低功耗  
導入AI平台



## Computer in Box

微型工業電腦



自動化應用

車聯網應用

## Computer with Panel



條形平板 PC



醫療顯示器



車載平板 PC



觸控平板 PC



條形顯示器



觸控顯示器



製造



車載



能源



醫療



軍工



零售博弈



AI伺服器



AGV/AMR

# 板類產品應用



## AI Workstation

Turnkey System Solution  
Patented COM Expansion Module  
Rapid Customization

Country: Europe

Learn More: <https://www.dfi.com/solution/successstory/79>

**WM343**  
microATX wall-mounted chassis

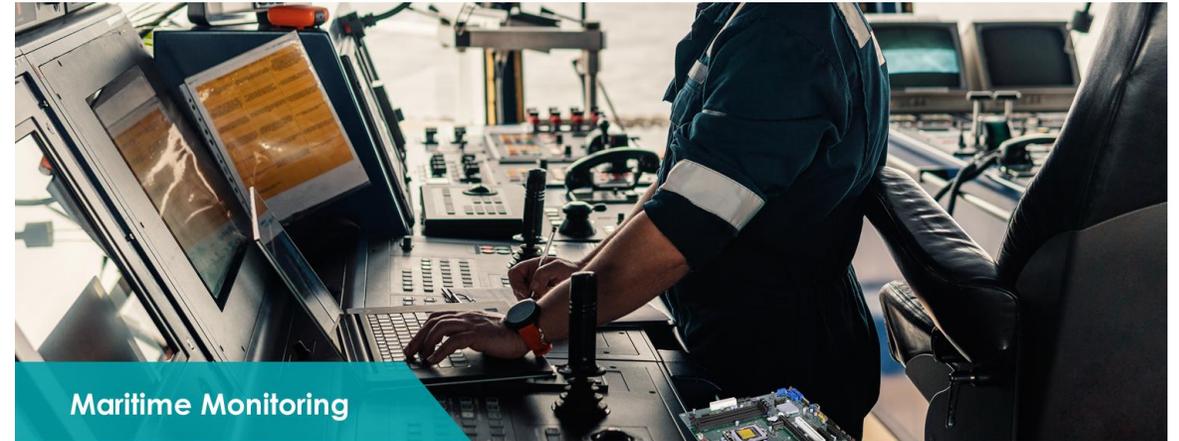


- Wallmount Chassis for microATX motherboard
- Designed for ATM application

**CMS310**  
industrial-grade motherboard



- 10<sup>th</sup> Gen Intel Core
- 4 DDR4 DIMM up to 128GB
- Three display
- Multiple expansion
- Rich I/O



## Maritime Monitoring

Customized 2U Rear I/O Bracket  
TI00-3E Riser Card  
Saving The Cost of Tooling and New Bracket

Country: Norway

Learn More: <https://www.dfi.com/solution/successstory/63>



**CS332-C246**  
With 2U Chassis (Guangshing GHA-214)

- Intel Atom Processor E3900 Series
- Up to 8GB DDR3L Single Channel Memory Down
- Rich I/O: 2 Intel GbE, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 CAN-bus
- GPS Onboard, 3 SIM Slots Onboard for Wifi, 3G/LTE support
- Supports Ignition Delay on/off Function



## Highway Vehicle Surveillance

High Performance  
High Reliability  
Miniature For Easy System Integration

Country: Turkey

Learn More: <https://www.dfi.com/solution/successstory/64>



**GHF51**  
1.8" SBC

- AMD Ryzen Embedded R1000 Series
- PI Size and Fanless Embedded System
- 4GB/8GB DDR4 memory onboard
- Supports 1 Mini PCIe for 3G/4G/LTE/WiFi
- 1 Intel GbE, 1 USB 3.1 Gen2, 2 micro HDMI



## EV Charger

Low power consumption  
Extended Temp Support  
Rich I/O Connectivity

Country: Korea



**3.5" SBC**

- Intel Atom® Amston Lake Processor
- 1 DDR5 SO-DIMM
- Triple Display: 1 HDMI, 1 Type-C DP Alt. Mode, 1 LVDS/eDP
- 4K High Resolution: Supports 4K/ 2K resolution
- Rich I/O ports: 3 2.5GbE LAN, 4 USB 3.2, 2 USB 2.0, 1 SATA
- Extended operating temp.: -40 to 80°C



# 三. Q & A

**Thank you**